

MLCC 开启新一轮涨价 关注订单溢出和国产替代

——电子行业研究周报



申港证券
SHENGANG SECURITIES

投资摘要:

每周一谈: MLCC 开启新一轮涨价 关注订单溢出和国产替代

龙头 MLCC 厂商开启新一轮涨价, 行业锁定长期供货, 产能转向致消费级订单外溢效应扩大。根据财联社, 日韩 MLCC 大厂开启新一轮涨价, 三星电机发布通知自 8 月 1 日起, MLCC 产品出货价格将在现行基础上统一上调 30%。太阳诱电发布通知, 宣布自 9 月 1 日起出货的 MLCC 将涨价。涨价主要源于 AI 带来的高端 MLCC 需求飙升, 原材料及辅料价格急剧上涨。AI 用服务器 MLCC 供应趋紧, 部分客户开始锁定长期供货, 三星电机日前宣布签署价值 2 亿美元的 AI 服务器 MLCC 供应合同, 合同期限为 2027 年全年, 此前 6 月已签署价值约 3 亿美元的 AI 服务器 MLCC 供应合同。根据 TrendForce 调查, 得益于 AI 需求旺盛, 6 月村田、三星电机、太阳诱电等三大厂商出货同步创下近五年单月新高, 消费级订单持续外溢, 渠道报价上涨。CSP 云端服务供应商自研 ASIC 平台拉货动能较好, 高容值、低电压、小尺寸 MLCC 成为市场增长亮点, 3 家 MLCC 厂商增长态势延续至七月。

日韩厂将消费级产能转向 AI 用高端规格, 消费级中高容 MLCC 产能受挤压, 主流料号的库存水位普遍已低于 30 天。在此挤出效应下, 渠道、代理商与 Tier 2/3 客户急单涌现, 订单外溢效应持续扩大, 其他制造商的接单能见度明显改善, 报价走高。整体消费级 MLCC 市场呈现“终端需求偏弱、渠道价格偏强”的结构性格局。

根据半导体产业纵横, 村田表示 AI 服务器、自动驾驶与边缘 AI 装置是推动被动元件需求的三大动能, 其中 AI 服务器 MLCC 用量较大, 算力突破、电源架构导致滤波、电源管理、抗干扰等周边元件需求暴增, 带动 MLCC 用量呈现结构性增长。GB300 平台需搭载约 3 万颗 MLCC, 约是手机的 30 倍, 车辆的三倍, 单一 AI 机柜消耗高达 44 万颗 MLCC。村田预估 2030 年 AI 服务器用 MLCC 需求将较 2025 年大增 3.3 倍, 行业有望迎来较高增速。供需矛盾下目前交货期有望延长, 半导体行业观察援引 Future Electronics 数据显示, 截至 7 月村田生产的 1 微法(μF)及以上 MLCC 的交货周期已长达 30 周, 与 6 月相比已增加 6 周。

AI 对高端 MLCC 需求带动日韩龙头厂商产能转向高端规格, 以及智能驾驶渗透率提高, 国内厂商有望受益订单溢出和国产份额替代, 具备高容高压、车规级 MLCC 量产能力的国产厂商有望率先受益。国产龙头企业中报业绩预告了较好的同比增长, 三环集团 MLCC 产品部分规格价格修复至原有合理价值, 销售量和销售额同比有较大幅度增长。风华高科得益于行业景气度上行, MLCC 等主营产品市场需求持续增长, 公司主营产品销量及单价同比上升。建议关注国产 MLCC 龙头及材料环节公司风华高科、三环集团、火炬电子、博迁新材。

投资策略: 近期国产全球参数最大的开源模型 Kimi K3 发布引发中美模型开源与闭源方式及未来市场格局的讨论, 叠加大型科技公司长鑫科技上市, 国产半导体扩产预期有望逐步落地, 我们认为国产 AI 产业链及半导体设备、封测、制造等环节关注度有望获得提升。目前模型性能提升中算力扩张仍是真实有效的路径, 其对算力性能和集群规模的依赖或仍将延续, 海外算力产业链及国产硬件产业链预计将同步受益。建议关注国产 MLCC 龙头及材料环节公司风华高科、三环集团、火炬电子、博迁新材。

风险提示: 贸易摩擦加剧, 需求复苏不及预期, 产能扩张不及预期, 竞争加剧

评级

增持(维持)

2026 年 08 月 02 日

王伟

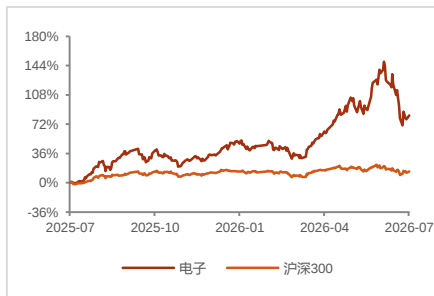
分析师

SAC 执业证书编号: S1660524100001

行业基本资料

股票家数	489
行业平均市盈率	71.0
市场平均市盈率	14.4

行业表现走势图



资料来源: 申港证券研究所

相关报告

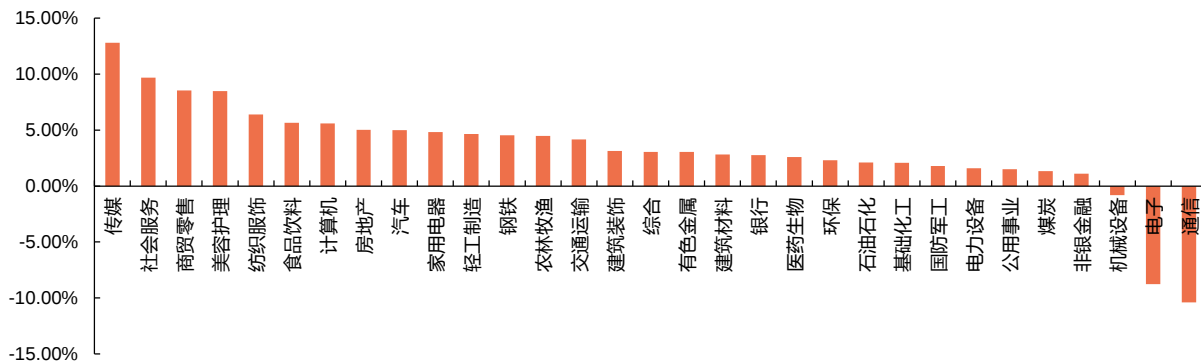
- 1、《电子行业研究周报: 台积电上调资本开支 存储代工涨价》2026-07-22
- 2、《电子行业研究周报: 美光上修美国本土投资计划 三星代工涨价》2026-07-17
- 3、《电子行业研究周报: 美光业绩展望 提振 AI 景气预期 代工产能布局转变》2026-07-03

1. 市场回顾

上周（7.27-7.31）申万电子行业指数下跌 8.77%，在申万 31 个行业中排名第 30，跑输沪深 300 指数 7.46%。本月至今（7.1-7.31）申万电子行业指数下跌 34.72%，在申万 31 个行业中排名第 31，跑输沪深 300 指数 26.86%。

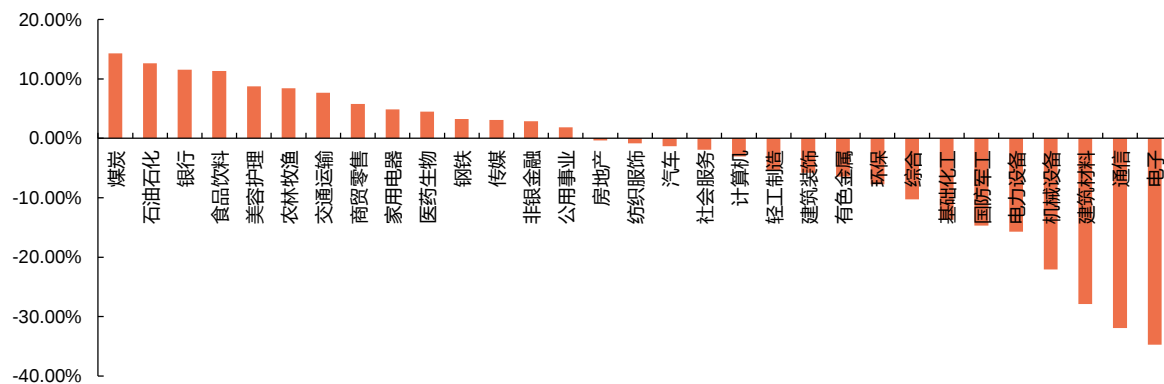
年初至今（1.1-7.31）申万电子行业指数上涨 21.61%，在申万 31 个行业中排名第 1，跑赢沪深 300 指数 22.52%。

图1：申万一级行业上周涨跌幅



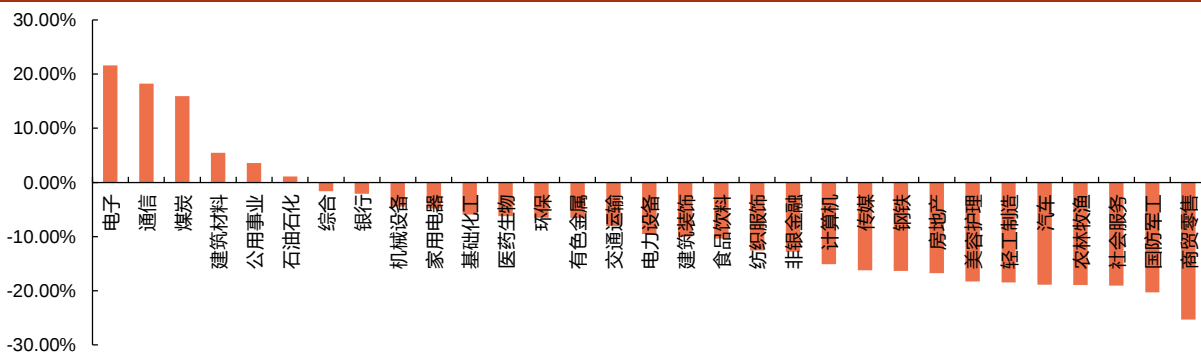
资料来源：wind，申港证券研究所

图2：申万一级行业本月至今涨跌幅



资料来源：wind，申港证券研究所

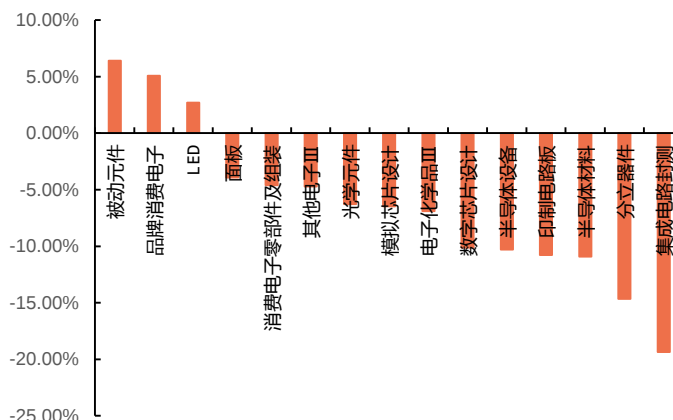
图3：申万一级行业年初至今涨跌幅



资料来源：wind，申港证券研究所

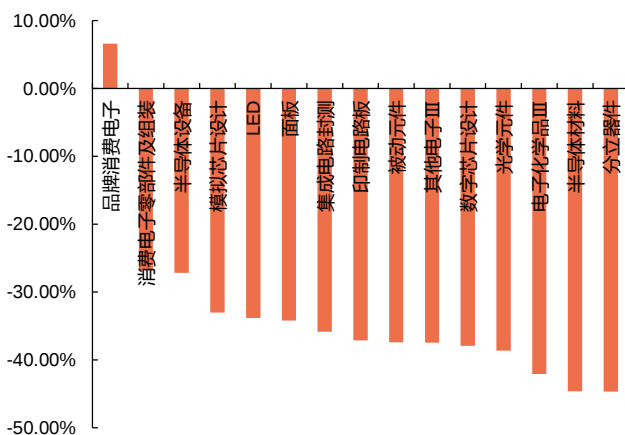
上周(7.27-7.31)申万电子行业三级子行业中被动元件、品牌消费电子、LED 指数涨跌表现相对靠前,相对沪深 300 指数涨跌幅 7.72%、6.39%、4.01%。

图4: 电子子行业上周涨跌幅



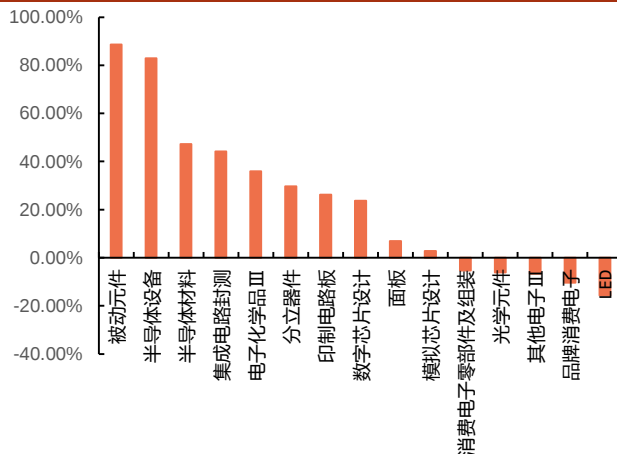
资料来源: wind, 申港证券研究所

图5: 电子子行业本月至今涨跌幅



资料来源: wind, 申港证券研究所

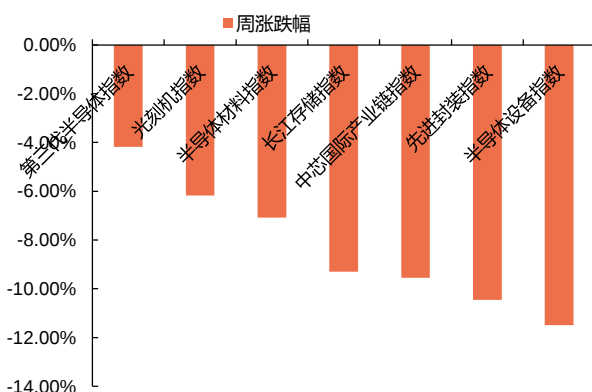
图6: 电子子行业年初至今涨跌幅



资料来源: wind, 申港证券研究所

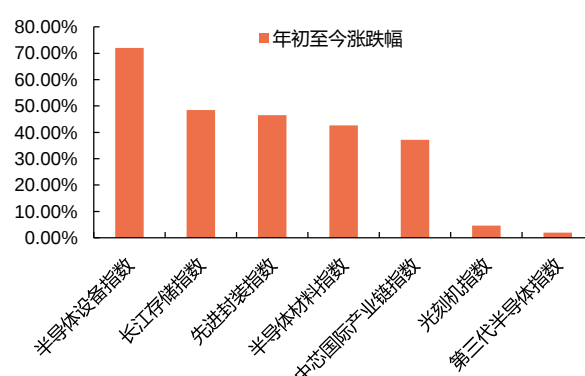
上周(7.27-7.31)万得半导体概念指数中第三代半导体指数、光刻机指数、半导体材料指数、长江存储指数、中芯国际产业链指数、先进封装指数、半导体设备指数涨跌幅分别为-4.18%、-6.17%、-7.08%、-9.30%、-9.55%、-10.45%、-11.49%。

图7: 万得半导体概念指数上周涨跌幅



资料来源: wind, 申港证券研究所

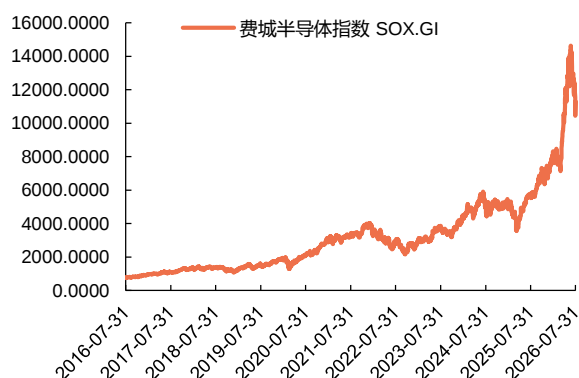
图8: 万得半导体概念指数年初至今涨跌幅



资料来源: wind, 申港证券研究所

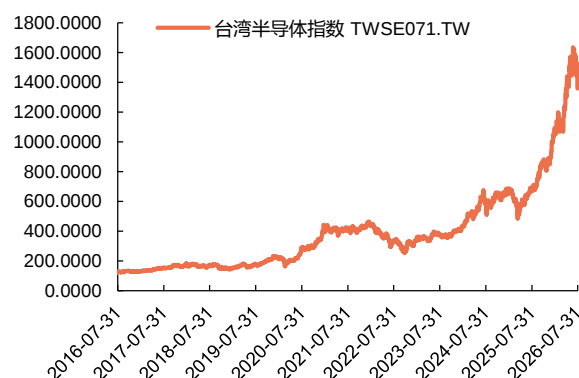
截至 2026 年 7 月 31 日，费城半导体指数收于 11311.08 点，周下跌 4.30%。台湾半导体指数收于 1494.81 点，周上涨 0.59%。

图9：费城半导体指数



资料来源：wind，申港证券研究所

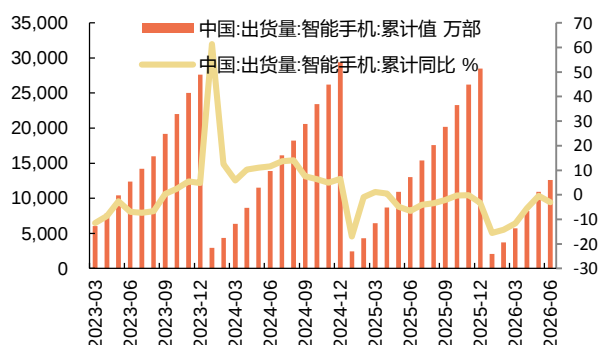
图10：台湾半导体指数



资料来源：wind，申港证券研究所

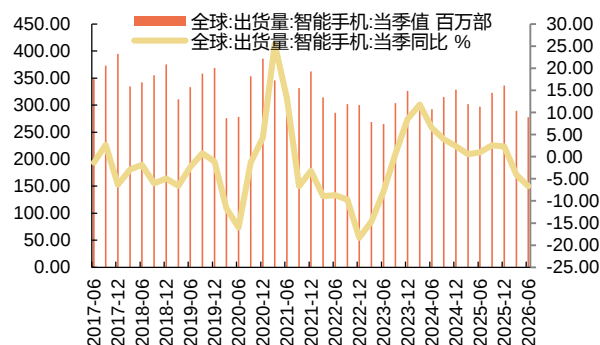
2. 行业数据跟踪

图11：中国智能手机出货量及累计同比



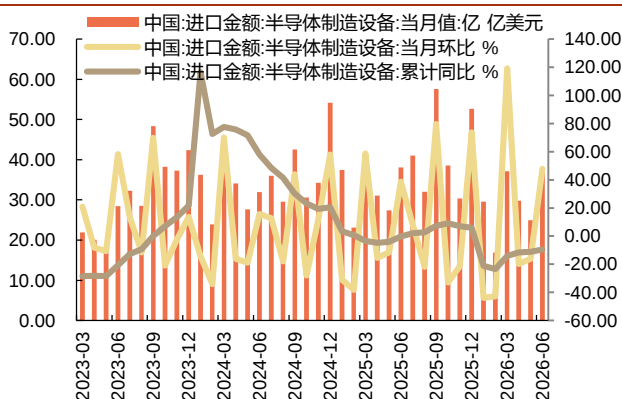
资料来源：wind，申港证券研究所

图12：全球智能手机出货量及当季同比



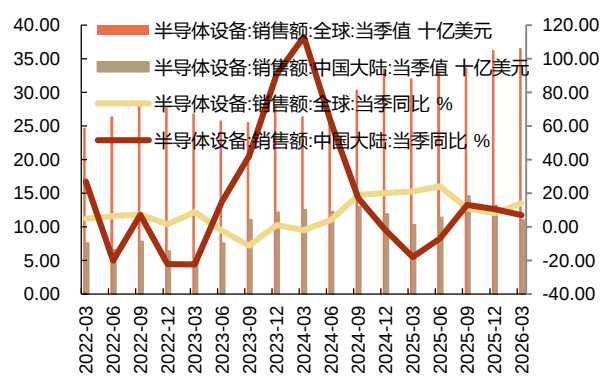
资料来源：wind，申港证券研究所

图13：中国进口半导体制造设备金额及同环比情况



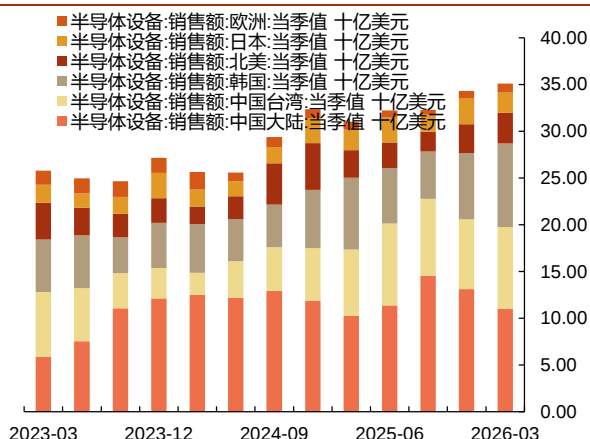
资料来源：wind，海关总署，申港证券研究所

图14：全球及中国大陆半导体设备销售额及同比



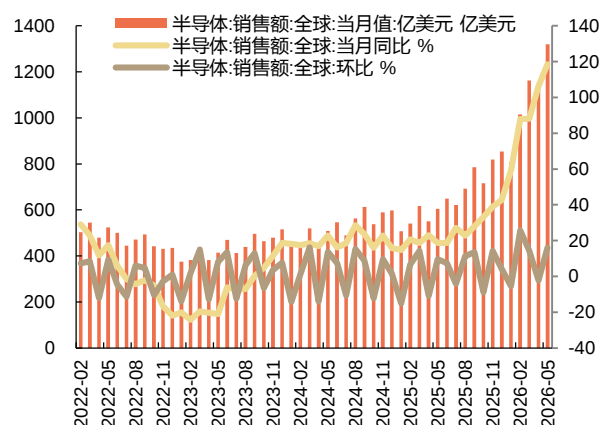
资料来源：ifind，日本半导体制造装置协会，申港证券研究所

图15: 主要地区半导体设备销售额



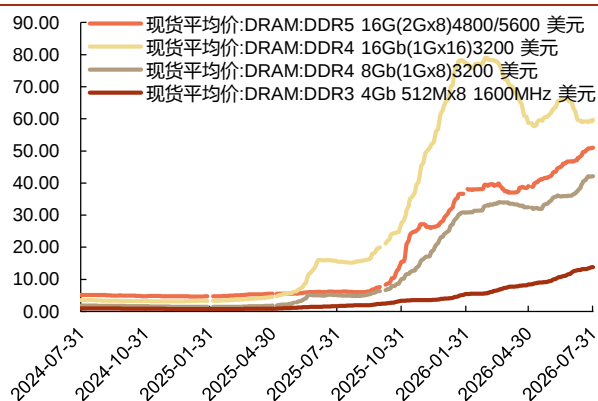
资料来源: ifind, 日本半导体制造装置协会, 申港证券研究所

图16: 全球半导体销售额及同环比情况



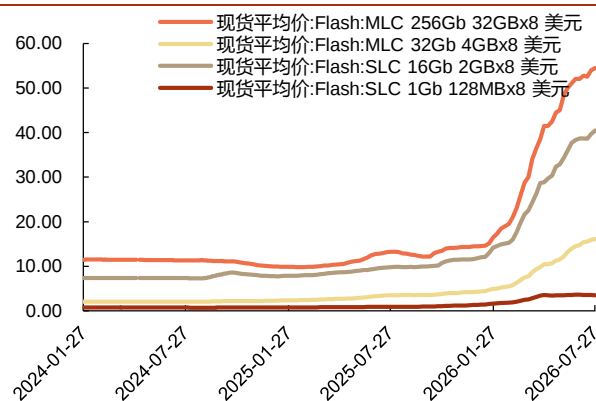
资料来源: ifind, 世界半导体贸易统计组织, 申港证券研究所

图17: DRAM 现货平均价



资料来源: ifind, 全球半导体现察 (DRAMexchange), 申港证券研究所

图18: NAND Flash 现货平均价



资料来源: ifind, 全球半导体现察 (DRAMexchange), 申港证券研究所

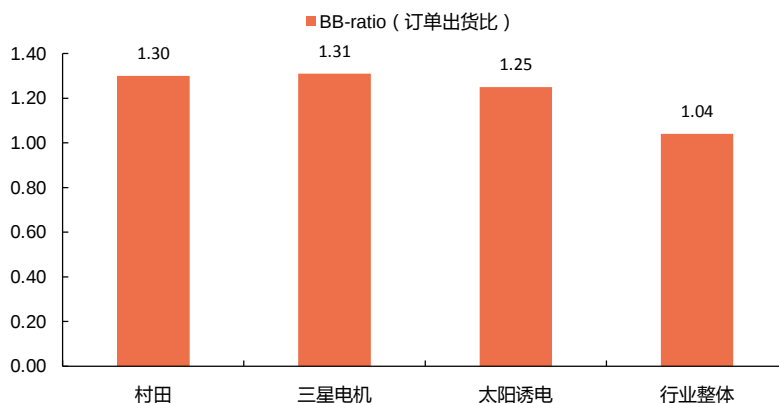
3. 每周一谈: MLCC 开启新一轮涨价 关注订单溢出和国产替代

龙头 MLCC 厂商开启新一轮涨价, 行业锁定长期供货, 产能转向致消费级订单外溢效应扩大。根据财联社, 日韩 MLCC 大厂开启新一轮涨价, 三星电机发布通知自 8 月 1 日起, MLCC 产品出货价格将在现行基础上统一上调 30%。太阳诱电发布通知, 宣布自 9 月 1 日起出货的 MLCC 将涨价。涨价主要源于 AI 带来的高端 MLCC 需求飙升, 原材料及辅料价格急剧上涨。AI 用服务器 MLCC 供应趋紧, 部分客户开始锁定长期供货, 三星电机日前宣布签署价值 2 亿美元的 AI 服务器 MLCC 供应合同, 合同期限为 2027 年全年, 此前 6 月已签署价值约 3 亿美元的 AI 服务器 MLCC 供应合同。根据 TrendForce 调查, 得益于 AI 需求旺盛, 6 月村田、三星电机、太阳诱电等三大厂商出货同步创下近五年单月新高, 消费级订单持续外溢, 渠道报价上涨。CSP 云端服务供应商自研 ASIC 平台拉货动能较好, 高容值、低电压、小尺寸 MLCC 成为市场增长亮点, 3 家 MLCC 厂商增长态势延续至七月。

日韩厂将消费级产能转向 AI 用高端规格, 消费级中高容 MLCC 产能受挤压, 主流料号的库存水位普遍已低于 30 天。在此挤出效应下, 渠道、代理商与 Tier 2/3 客

户急单涌现，订单外溢效应持续扩大，其他制造商的接单能见度明显改善，报价走高。整体消费级 MLCC 市场呈现“终端需求偏弱、渠道价格偏强”的结构性格局。

图19：6月下旬三大龙头厂商订单出货比创新高显示短缺风险提高



资料来源：TrendForce，申港证券研究所

根据半导体产业纵横，村田表示 AI 服务器、自动驾驶与边缘 AI 装置是推动被动元件需求的三大动能，其中 AI 服务器 MLCC 用量较大，算力突破、电源架构导致滤波、电源管理、抗干扰等周边元件需求暴增，带动 MLCC 用量呈现结构性增长。GB300 平台需搭载约 3 万颗 MLCC，约是手机的 30 倍，车辆的三倍，单一 AI 机柜消耗高达 44 万颗 MLCC。村田预估 2030 年 AI 服务器用 MLCC 需求将较 2025 年大增 3.3 倍，行业有望迎来较高增速。供需矛盾下目前交货期有望延长，半导体行业观察援引 Future Electronics 数据显示，截至 7 月村田生产的 1 微法(μF)及以上 MLCC 的交货周期已长达 30 周，与 6 月相比已增加 6 周。

AI 对高端 MLCC 需求带动日韩龙头厂商产能转向高端规格，以及智能驾驶渗透率提高，国内厂商有望受益订单溢出和国产份额替代，具备高容高压、车规级 MLCC 量产能力的国产厂商有望率先受益。国产龙头企业中报业绩预告了较好的同比增长，三环集团 MLCC 产品部分规格价格修复至原有合理价值，销售量和销售额同比有较大幅度增长；风华高科得益于行业景气度上行，MLCC 等主营产品市场需求持续增长，公司主营产品销量及单价同比上升。建议关注国产 MLCC 龙头及材料环节公司风华高科、三环集团、火炬电子、博迁新材。

4. 行业动态

尹志尧：中微未来五年至少覆盖六成半导体高端设备和七成先进封装设备

中微公司董事长尹志尧，1日在公司成立22周年庆典上表示，要在未来五年内至少覆盖60%的半导体高端设备，成为全球覆盖率最高的半导体设备公司，到2035年在规模、产品竞争力上成为全球第一梯队的半导体设备公司。尹志尧还表示，公司在五年左右时间将覆盖60%以上的集成电路高端关键设备和70%以上的先进封装设备，成为集成电路设备的平台型公司。（来源：集微网）

长鑫存储 LPDDR6 研发验证进入尾声 国产高端存储芯片量产在即

国产存储芯片领域传来重大进展。据报道，长鑫存储自主研发的 LPDDR6 芯片已接近研发验证尾声，距离首发量产更近一步。这意味着，在全球下一代移动内存芯片的量产竞赛中，中国企业已与韩国头部厂商并驾齐驱，有望打破海外巨头长期主导高端存储芯片市场的格局。此次长鑫存储即将推出的首款 LPDDR6 产品，在性能参数上实现了显著突破。据介绍，该产品规格速率高达 12800 Mbps，与 SoC 协同的运行基础速率为 10667Mbps；颗粒容量为 16Gb，芯片容量达到 16GB，采用 1295 Ball 的 POP 封装。相比此前发布的 LPDDR5X 产品，新品在低功耗设计和 RAS（可靠性、可用性和可维护性）功能上均有明显优化提升。（来源：集微网）

Google 传 2028 年部署最多 1500 万颗 TPU 规模可能超越英伟达

市场研究报告指出，Google 计划在 2028 年部署 1,200 万至 1,500 万颗第九代张量处理器 (TPU v9)，若计划顺利落实，单以芯片数量计算，可能追平甚至超越 AI 巨头英伟达同年出货的数据中心 AI GPU。Google 约十年前便开始研发自有 AI 加速器，近年也持续提高 TPU 部署规模。报告引述供应链调查指出，Google 预计在 2028 年让 TPU 进入第九代，并采用 4 颗运算晶粒设计，因此消耗的先进制程与封装产能可能较 2027 年增加一倍以上。

估计英伟达 2026 年供应约 820 万颗数据中心 AI GPU，2028 年出货量可能提高至 1,240 万颗。若 Google 届时确实生产 1,200 万至 1,500 万颗 TPU v9，其 AI 加速器数量将与英伟达相当，高标甚至可能超越英伟达。（来源：集微网）

SEMI：2026 年 Q2 全球硅晶圆出货量同比增长 7.4%、环比增长 9.1%

7月29日，SEMI 旗下 Silicon Manufacturers Group (SMG) 发布的硅片行业季度分析报告显示，2026 年第二季度全球硅晶圆出货量同比增长 7.4%，达到 3573 百万平方英寸 (MSI)，2025 年同期为 3327 百万平方英寸。出货量较 2026 年第一季度记录的 3275 百万平方英寸环比增长 9.1%。（来源：集微网）

传台积电研发类 EMIB 封装技术 携手欣兴抗衡英特尔

根据《财联社》报道，AI 芯片产能战火正烧向后段封装，两名知情人士透露，台积电正与中国台湾载板大厂欣兴电子合作，研发一款技术路线对标英特尔 EMIB 的先进封装方案，内部工程师称之为「类 EMIB 技术」，目前已与部分客户初步沟通，但工程仍处在早期，尚无明确量产时程。报道指出，台积电这次牵手欣兴是关键信号。在 EMIB 架构下，载板需内嵌硅桥并连通上层元件，欣兴的 ABF 载板能力正好补上台积电在基板端的拼图。

分析人士指出，AI 热潮正逼出封装「双轨制」：CoWoS 守住旗舰训练芯片高地，类 EMIB 与面板级 CoPoS 则补齐大尺寸、成本敏感与供应链分散化需求。台积电不等产

能缺口养大对手,先进封装军备赛已进入「前段制程+后段整合」全端对决。(来源:集微网)

5. 风险提示

贸易摩擦加剧,需求复苏不及预期,产能扩张不及预期,竞争加剧

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人独立研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处，不受任何第三方的影响和授意。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

免责声明

申港证券股份有限公司（简称“本公司”）是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性和完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。

申港证券研究所已力求报告内容的客观、公正，但报告中的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖出价或征价，不构成其他投资标的的要约和邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。投资者不应单纯依靠本报告而取代自身独立判断，应自主作出投资决策并自行承担投资风险，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载资料、意见及推测仅反映申港证券研究所于发布本报告当日的判断，本报告所指证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会产生波动，在不同时期，申港证券研究所可能会对相关的分析意见及推测做出更改。本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。

本报告仅面向申港证券客户中的专业投资者及风险承受能力为 C3、C4、C5 的普通投资者，本公司不会因接收人收到本报告而视其为当然客户。本报告版权归本公司所有，未经事先许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如转载或引用，需注明出处为申港证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、发布、转载和引用者承担。

投资评级说明

申港证券行业评级说明：增持、中性、减持

增持	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 5% 以上
中性	报告日后的 6 个月内，相对于市场基准指数收益率介于 -5%~+5% 之间
减持	报告日后的 6 个月内，相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上

（基准指数说明：A 股市场基准为沪深 300 指数；香港市场基准为恒生指数；美国市场基准为标普 500 指数或纳斯达克指数。）

申港证券公司评级说明：买入、增持、中性、减持

买入	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 15% 以上
增持	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 5%~15% 之间
中性	报告日后的 6 个月内，相对于市场基准指数收益率介于 -5%~+5% 之间
减持	报告日后的 6 个月内，相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上

（基准指数说明：A 股市场基准为沪深 300 指数；香港市场基准为恒生指数；美国市场基准为标普 500 指数或纳斯达克指数。）